

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 10 月 4 日(04.10.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/132965 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) *C08J 5/24* (2006.01)
B32B 15/092 (2006.01) *C08K 3/22* (2006.01)
C08G 59/42 (2006.01) *C08K 5/092* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/056895
- (22) 国際出願日: 2012 年 3 月 16 日(16.03.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-078736 2011 年 3 月 31 日(31.03.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱瓦斯化学株式会社 (Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.) [JP/JP]; 〒1008324 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高田 圭輔 (TAKADA, Keisuke) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 小泉 薫 (KOIZUMI, Kaoru) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 森下 宏治 (MORISHITA, Koji) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社東京テクノパーク内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 稲葉 良幸, 外 (INABA, Yoshiyuki et al.); 〒1066123 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 23 階 TMI 総合法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: RESIN COMPOSITION, PRE-PREG, AND METAL FOIL CLAD LAMINATE

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、プリプレグ及び金属箔張積層板

(57) Abstract: Provided are a resin composition, pre-preg therefor, and metal foil clad layer plate, that can be suitably used as a printed wiring board for LED packaging with high light reflectivity in the ultraviolet light region and the visible light region, that does not lose light reflectivity due to heating and light irradiation, and that also has excellent peel strength relative to a metal foil. This resin composition includes at least (A) an epoxy resin having a bisphenol A backbone, (B) an alicyclic epoxy resin, (C) an acid anhydride of a partially hydrogenated compound or a totally hydrogenated compound of an aromatic polycarboxylic acid, (D) titanium dioxide, and (E) a dispersing agent.

(57) 要約: 紫外光領域及び可視光領域において光反射率が高く、また、加熱処理および光照射処理による光反射率の低下が少なく、さらには金属箔とのピール強度にも優れ、LED実装用プリント配線板に好適に用いることのできる樹脂組成物、及びこれを用いたプリプレグ、金属箔張積層板等を提供する。本発明の樹脂組成物は、ビスフェノールA骨格を有するエポキシ樹脂(A)、脂環式エポキシ樹脂(B)、芳香族ポリカルボン酸の完全水素化物または部分水素化物の酸無水物(C)、二酸化チタン(D)、及び分散剤(E)を少なくとも含有するものである。



WO 2012/132965 A1